

概述

BP2608A 是一款高效率、高 PF 值、低 THD 的恒压控制芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式，适用于 Boost 架构的功率因素校正电路。BP2608A 在输出轻载时进入间歇工作模式，确保输出电压不飘高，可降低输出电解电容电压应力。

BP2608A 采用源极驱动和电流检测方式，芯片的工作电流极低，只需要很少的外围元件，即可实现优异的恒流特性，极大的节约了系统成本和体积。

BP2608A 具有多重保护功能，包括负载开路保护（过压保护），MOS 过流保护，芯片温度过热调节等。

BP2608A 采用 SOP-8 封装。

特点

- 临界连续电流控制模式
- 芯片超低工作电流
- 高精度输出电压基准
- 负载开路保护
- MOS 过流保护
- 芯片供电欠压保护
- 芯片结温过热保护
- 采用 SOP-8 封装

应用

- Boost APFC 恒压电路

典型应用

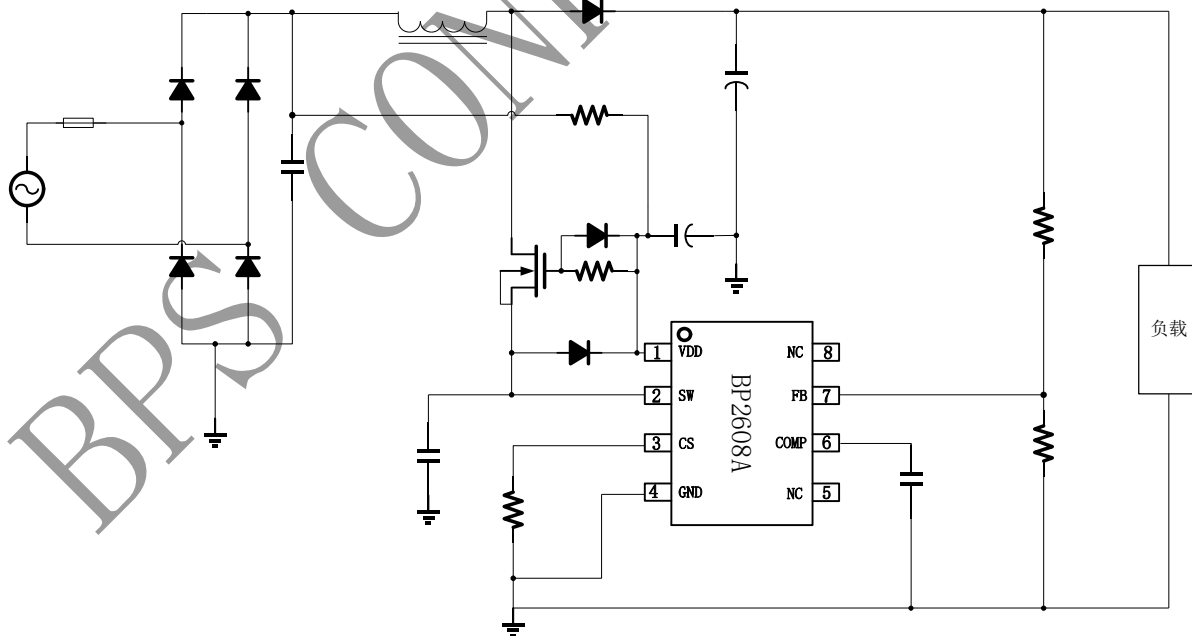


图 1 BP2608A 恒压典型应用图



晶丰明源半导体

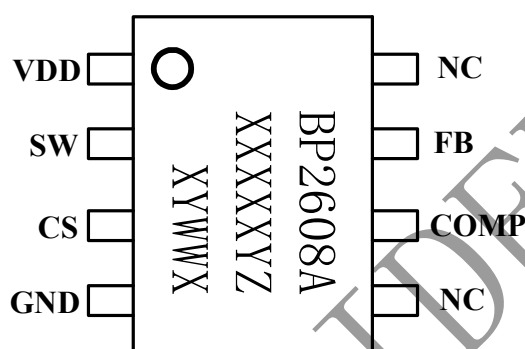
BP2608A

BOOST PFC 恒压控制芯片

订购信息

订购型号	封装	温度范围	包装形式	打印
BP2608A	SOP8	-40 °C到 105 °C	编带 4,000 颗/盘	BP2608A XXXXXYZ XYWWZ

管脚封装



XXXXXY: lot code

XY: 标示

WW: 周号

Z: 预留位

图2 管脚封装图

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	VDD	芯片供电脚
2	SW	Boost 驱动输出端，接外部开关管源极
3	CS	Boost 开关管电流采样脚
4	GND	芯片地
5	NC	悬空
6	COMP	Boost 回路补偿脚
7	FB	输出电压控制脚
8	NC	悬空

免责声明

晶丰明源尽力确保本产品规格书内容的准确和可靠，但是保留在没有通知的情况下，修改规格书内容的权利。

本产品规格书未包含任何针对晶丰明源或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息，晶丰明源不做任何明示或暗示的保证，包括但不限于对规格书内容的准确性、商业上的适销性、特定目的的适用性或者不侵犯晶丰明源或任何第三人知识产权做任何明示或暗示保证，晶丰明源也不就因本规格书本身及其使用有关的偶然或必然损失承担任何责任。

BPS Confidential